espacenet — Dionographic data

NEW EPOXY COMPOUND, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, CURABLE EPOXY RESIN COMPOSITION AND CURED PRODUCT THEREOF

Publication number: JP2005097473 (A)

Publication date:

2005-04-14

Inventor(s):

HAYAKAWA ATSUTO; ITO AKIHIRO +

Applicant(s):

JAPAN EPOXY RESIN KK +

Classification:

- international:

C08G59/06; C08G59/00; (IPC1-7): C08G59/06

- European:

Application number: JP20030335204 20030926 Priority number(s): JP20030335204 20030926

Abstract of JP 2005097473 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an epoxy compound solid at normal temperature, having low melt viscosity and excellent curability, and providing a cured product having excellent mechanical strength, heat resistance and moisture resistance; and to provide a method for producing the epoxy compound, an epoxy resin composition, and a cured product thereof. SOLUTION: The epoxy compound is represented by general formula (I) (wherein, R<SP>1</SP>to R<SP>10</SP>are each a hydrogen atom or a 1-6C alkyl group; and n is an integer of >=0). The method for producing the compound, the epoxy resin composition and the cured product thereof are also provided.; COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI

Also published as:

閏 JP4354242 (B2)

Data supplied from the espacenet database - Worldwide

(19) **日本国特許厅(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

###2005-97473 (P2X5-97473A)

(43) 公開日 平成17年4月14日(2005.4.14)

(S1) Int, C1. T

FI

テーマコード (参考)

CO86 59/06

COSG 59/06

41036

審査證末 未請求 請求項の数 11 OL (全 16 頁)

(21) 出願番号

特願2003-335204 (P2003-335204)

(22) 出題日

平成15年9月26日 (2003.9.26)

(71) 出願人 000246239

ジャパンエポキシレジン株式会社

東京都中央区日本橋二丁目3番4号

[(74)代理人 100095175

弁理士 渡辺 秀夫

(72) 発明者 早川 淳人

三 重県四日市市塩炭町1番地 ジャパンエ

ポキシレジン株式会社開発研究所内

(72) 発明者 伊藤 明広

三重県四日市市塩浜町1番地 ジャパンエ

ポキシレジン株式会社開発研究所内

Pターム(参考) 41036 AEO7 BAO1 DB06 DB11 DB15

DE23 DC02 DC16 DC31 DC41

DD04 DD07 FB07 FB08 GA06

(54) [発明の名称] 新規エポキシ化合物、その製造方法、硬化性エポキシ樹脂組成物およびその硬化体

(57)【要約】

【目的】 常温で固体であり、低溶融粘度を有し、硬化性に優れ、機械強度、耐熱性、耐湿性に優れた硬化物を与える、エポキシ化合物とその製造方法及びエポキシ樹脂組成物とその硬化体を提供する。

【構成】 一般式(1)で表されるエポキシ化合物。

一般式(1)

[化1]

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(1)で表されるエポキシ化合物。

一般式(1)

【化1】

(ただし、 $R^1 \sim R^{1.0}$ は水素原子または炭素数 1 から 6 までのアルキル基を示す。 n は 0 以上の整数を示す。)

【請求項2】

請求項1に記載されたエポキシ化合物であって、一般式(I)の、 $R^1 \sim R^{10}$ が水素原子、または R^3 、 R^4 がメチル基かつ他のRが水素原子である、エポキシ化合物。

【請求項3】

一般式(II) で表されるジヒドロアントラハイドロキノン化合物をエピハロヒドリンと 反応させることを特徴とする、請求項1または2に記載されたエポキシ化合物の製造方法

一般式(II)

[化2]

(ただし、 $R^1 \sim R^{10}$ は水素原子または炭素数1から6までのアルキル基を示す。)

【請求項4】

請求項3に記載されたエポキシ化合物の製造方法であって、一般式(II)の、 $R^1 \sim R^{10}$ が水素原子、または R^3 、 R^4 がメチル基かつ他のRが水素原子である、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物をエピハロヒドリンと反応させることを特徴とする、エポキシ化合物の製造方法。

[請求項5]

一般式(III)で表される、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物をエピハロヒドリンと反応させることを特徴とする、請求項1に記載されたエポキシ化合物の製造方法。

20

30

一般式(111)

[化3]

10

(ただし、A はカリウム原子またはナトリウム原子を示し、 $R^1 \sim R^{10}$ は水素原子または炭素数 1 から 6 までのアルキル基を示す。)

【請求項6】

請求項5に記載されたエポキシ化合物の製造方法であって、一般式(III)において、 $R^1 \sim R^{10}$ が水素原子である、または R^3 、 R^4 がメチル基かつ他のRが水素原子である、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物をエピハロヒドリンと反応させることを特徴とする、エポキシ化合物の製造方法。

20

【請求項7】

一般式(III)で表される、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物をエピハロヒドリンと反応させてエポキシ化合物を製造するにあたり、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物を水溶液として反応系内に供給する、請求項5に記載されたエポキシ化合物の製造方法。

【請求項8】

エピハロヒドリンと反応させるジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属 塩水溶液濃度5~50重量%である、請求項7に記載されたエポキシ化合物の製造方法。 【請求項9】

30

ジヒドロアントラハイドロキノン化合物1モルに対し、エピハロヒドリンを4~40モル使用して均一な溶液とし、これにジヒドロアントラハイドロキノン化合物1所る当たり1.8~5モルのアルカリ金属水酸化物を加えて反応させる、請求項3~8のいずれか1項に記載されたエポキシ化合物の製造方法。

【請求項10】

(a) 1分子中2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂、(b) 硬化剤、及び(c) 硬化促進剤を必須成分とする硬化性エポキシ樹脂組成物であり、(a) のエポキシ樹脂中に請求項1または2に記載のエポキシ化合物を5~100質量%含む硬化性エポキシ樹脂組成物。

【請求項11】

40

請求項10に記載された硬化性エポキシ樹脂組成物を硬化させた硬化体。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、常温で固体であり取り扱い性に優れ、かつ溶融状態において極めて低溶融粘度を有し、硬化性に優れており、機械的強度、耐熱性及び耐湿性に優れた硬化物を与える新規エポキシ化合物およびその製造方法に関し、さらに、電気・電子部品の封止材料、成形材料、注型材料、積層材料、複合材料、接着剤及び粉体塗料等の用途に有用である、本発明の新規エポキシ化合物を含有してなる硬化性エポキシ樹脂組成物およびその硬化体に

関する。

【背景技術】

[0002]

エポキシ化合物は種々の硬化剤で硬化させることにより、機械的性質、耐湿性、電気的性質などに優れた硬化物を与えるので電気・電子部品の封止材料、成形材料、注型材料、 複層材料、複合材料、接着剤及び粉体塗料等などの幅広い分野に利用されている。しかしながら、技術の進歩に伴い、エポキシ化合物の高性能化に対する要求が高まってきており従来のエポキシ化合物ではその要求に対応できなくなってきた。例えば、電気・電子用途の分野においては電子部品の小型化、薄型化技術の進展に伴い、低粘度のエポキシ化合物望まれているが、これは小型化した部品内部の狭い空隙にも十分に樹脂を送り込ませる必要があるためである。低粘度のエポキシ化合物としてはビスフェノールAのジグリシジルエーテルやビスフェノールFのジグリシジルエーテル等が広く用いられているがこれらのエポキシ化合物は常温で液状または粘稠であり、用途によっては取り扱いが困難であり作業が劣る。さらにこれらのエポキシ化合物を用いた硬化体は機械的強度や耐熱性および耐湿性が十分でない。

これらの問題点を解決するために常温以上で結晶性を有するエポキシ化合物を用いる技術が提案されている。例えば、テトラメチルビフェニル型エポキシ化合物(特許文献 1)、スチルベン型エポキシ化合物(特許文献 2)などである。しかし、これらのエポキシ化合物はエポキシ基の近くに嵩高い置換基がついているので溶融粘度が高く、さらに硬化性の点で十分とはいえない。またこれらのエポキシ化合物を用いた硬化体は耐熱性や耐湿性につき、前述のビスフェノール A型エポキシ化合物を用いた硬化体に比べ、幾分向上するが、用途によっては不十分である。

【特許文献1】特公平7-53791号公報

【特許文献2】特閱平9-12674号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

100031

本発明は、常温で固体であり取り扱い性に優れ、かつ溶融状態において極めて低溶融粘度を有し、硬化性に優れており、機械的強度、耐熱性及び耐湿性に優れた硬化物を与える新規エポキシ化合物およびその製造方法に関し、さらに、電気・電子部品の封止材料、成形材料、注型材料、積層材料、複合材料、接着剤及び粉体塗料等の用途に有用である、本発明の新規エポキシ化合物を主成分として含有してなる硬化性エポキシ樹脂組成物およびその硬化体を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

[0004]

本発明者等は、前記の課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定の化学構造を持つエポキシ化合物が常温で結晶であるので固体状を維持でき、融点以上では極めて低い粘度を有すること、およびその新規エポキシ化合物を用いた硬化性エポキシ樹脂組成物は硬化性に優れ、機械的強度、耐熱性及び耐湿性に優れた硬化体を与えることを見出し、本発明を完成させるに至った。

すなわち、本発明は、以下の各発明を包含する。

「(1)一般式(1)で表されるエポキシ化合物。

一般式(I)

[0005]

10

20

30

[化4]

(ただし、 $R^1 \sim R^{10}$ は水素原子または炭素数 I から G までのアルキル基を示す。 n は O 以上の整数を示す。)

- (2)請求項1に記載されたエポキシ化合物であって、一般式(I)の、 $R^1 \sim R^{10}$ が水素原子、または R^3 、 R^4 がメチル基かつ他のRが水素原子である、エポキシ化合物。
- (3) 一般式 (II) で表されるジヒドロアントラハイドロキノン化合物をエピハロヒドリンと反応させることを特徴とする、1項に記載されたエポキシ化合物の製造方法。

一般式(II)

[0006]

[化5]

(ただし、 $R^1 \sim R^{10}$ は水素原子または炭素数 1 から 6 までのアルキル基を示す。)

- (4)請求項3に記載されたエポキシ化合物の製造方法であって、+一般式(II)の、 R^1 $\sim R^{10}$ が水素原子、または R^3 、 R^6 がメチル基かつ他のR が水素原子である、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物をエピハロヒドリンと反応させることを特徴とする、エポキシ化合物の製造方法。
- (5) 一般式(III) で表される、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物をエビハロヒドリンと反応させることを特徴とする、1項に記載されたエポキシ化合物の製造方法。

一般式(III)

[0007]

20

30

20

30

(ただし、A はカリウム原子またはナトリウム原子を示し、 $R^1 \sim R^{10}$ は水素原子または炭素数 1 から 6 までのアルキル基を示す。)

(6)5項に記載されたエポキシ化合物の製造方法であって、一般式(III)において、R 1 ~ R^{10} が水素原子である、または R^{3} 、 R^{4} がメチル基かつ他のRが水素原子である、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物をエピハロヒドリンと反応させることを特徴とする、エポキシ化合物の製造方法。

(7) 一般式(III) で表される、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物をエピハロヒドリンと反応させてエポキシ化合物を製造するにあたり、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物を水溶液として反応系内に供給する、5項に記載されたエポキシ化合物の製造方法。

(8) エピハロヒドリンと反応させるジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩水溶液濃度5~50重量%である、7項に記載されたエポキシ化合物の製造方法。(9) ジヒドロアントラハイドロキノン化合物1モルに対し、エピハロヒドリンを4~4

0 モル使用して均一な溶液とし、これにジヒドロアントラハイドロキノン化合物1所る当たり1.8~5モルのアルカリ金属水酸化物を加えて反応させる、3項~8項のいずれか1項に記載されたエポキシ化合物の製造方法。

(10)(a)分子中2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂、(b)硬化剤、及び(c)硬化促進剤を必須成分とする硬化性エポキシ樹脂組成物であり、(a)のエポキシ樹脂中に、1項または2項に記載されたエポキシ化合物を5~100質量%含む、硬化性エポキシ樹脂組成物。

(11)10項に記載された硬化性エポキシ樹脂組成物を硬化させた硬化体。」 に関する。

【発明の効果】

[00008]

本発明のエポキシ化合物は結晶性であり、常温で固形であるので取り扱い性に優れ、かつ溶融状態において極めて低溶融粘度を有する。またそのエポキシ化合物を用いた硬化性エポキシ樹脂組成物は硬化性に優れ、また機械的強度、耐熱性及び耐湿性に優れた硬化体を与えるので、電気・電子部品の封止材料、成形材料、注型材料、積層材料、複合材料、接着剤及び粉体塗料等の用途に有用である。

40

50

【発明を実施するための最良の形態】

[00009]

前記一般式(I)で表される本発明のエポキシ化合物は、一般式(II)で表されるジヒドロアントラハイドロキノン化合物とエピハロヒドリンとをアルカリ金属水酸化物の存在下に反応させて得ることができる。例えば、不活性ガス気流下、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物1モル当たり4~40モルに相当する量のエピハロヒドリンに溶解させて均一な溶液とする。ついで、その溶液を撹拌しながらこれにジヒドロアントラハイドロキノン化合物1モル当たり1.8~5モル量のアルカリ金属水酸化物を固体または水溶

液で加えて反応させる。この反応は、常圧下または減圧下で行わせることができ、反応温度は通常、常圧下の反応の場合は30~120℃であり、減圧下の反応の場合は30~80℃である。反応は必要に応じて所定の温度を保持しながら反応液を共沸させ、揮発する蒸気を冷却して得られた凝縮液を油/水分離し、水分を除いた油分を反応系へ戻す方法により脱水することができる。アルカリ金属水酸化物の添加は、急激な反応を抑えるために、1~8時間かけて少量ずつを断続的もしくは連続的に添加する。その全反応時間は通常、1~10時間である。なお、反応が終了するまで系内は不活性ガス雰囲気であることが望ましい。ここでいう不活性ガスとは、例えば、窒素、アルゴンなどをいう。

[0010]

本発明の新規エポキシ化合物の製造において、本発明の特長である結晶性と低粘度性を両立させるためには、例えば、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物に対するエピハロヒドリンのモル比で制御することができる。ジヒドロアントラハイドロキノン化合物1モルに対するエピハロヒドリンのモル比は好ましくは4~40モル、より好ましくは8~20モルである。このモル比が4より低いとエポキシ化合物の溶融粘度が高くなり、40より高くてもエポキシ化合物の粘度はそれ以上低くならないばかりか、未反応のエピハロヒドリンの留去に手間がかかり非効率的である。

反応終了後、不溶性の副生塩を濾別して除くか、水洗により除去した後、未反応のエピ ハロヒドリンを減圧留去して除くと、目的のエポキシ化合物が得られる。

この反応におけるエピハロヒドリンとしては通常、エピクロルヒドリンまたはエピプロモヒドリンが用いられる。アルカリ金属水酸化物としては通常、水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムが用いられる。

[0011]

また、この反応においては、テトラメチルアンモニウムクロリド、テトラエチルアンモニウムプロミドなどの第4級アンモニウム塩:ベンジルジメチルアミン、2、4、6ートリス (ジメチルアミノメチル) フェノールなどの第3級アミン;2ーエチルー4ーメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾールなどのイミダゾール類:エチルトリフェニルホスホニウムアイオダイドなどのホスホニウム塩;トリフェニルホスフィンなどのホスフィン類等の触媒を用いても良い。

さらにこの反応においては、エタノール、2ープロパノールなどのアルコール類;アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類;ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテルなどのエーテル類;メトキシプロパノールなどのグリコールエーテル類;ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミドなどの非プロトン性極性溶媒等の不活性な有機溶媒を単独または2種以上組み合わせて使用しても良い。

さらに上記のようにして得られたエポキシ化合物の可鹸化ハロゲン量が多すぎる場合は、再処理して十分に可鹸化ハロゲン量が低下した精製エポキシ化合物を得ることができる。つまり、その粗製エポキシ化合物を、2ープロパノール、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、トルエン、キシレン、ジオキサン、メトキシプロパノール、ジメチルスルホキシドなどの不活性な有機溶媒に再溶解しアルカリ金属水酸化物を固体または水溶液で加えて約30~120℃の温度で0.5~8時間再開環反応を行った後、水洗等の方法で過剰のアルカリ金属水酸化物や副生塩を除去し、さらに有機溶媒を減圧留去して除くと、精製されたエポキシ化合物が得られる。

[0012]

また、本発明のエポキシ化合物はあらかじめ調製したジヒドロアントラハイドロキノン 化合物のアルカリ金属塩をエピハロヒドリンと反応させて製造することもできる。この場合、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩はそのままあるいは、水溶液でエピハロヒドリン中に添加するが、急激な反応を防ぐために、少量づつ分割して系内へ添加することが望ましい。

また、水溶液として供給した場合は、閉環反応を十分に進行させるために、途中で系内の 水を除去した後、アルカリ金属水酸化物を固形または水溶液で添加してエポキシ化率をあ げることが望ましい。 10

20

èn.

40

20

30

40

50.

また、そのジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩水溶液の濃度は5~50質量%、望ましくは15~30質量%である。5質量%より低濃度では、系内に持ち込む水の量が増え、エポキシ化反応の進行を阻害することがある。50質量%より多いと、水溶液の流動性が低下し、装置の配管を閉塞するなどのおそれがあるのでよくない。また、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩水溶液は、安定化のために、塩を形成させるに必要な当量以上のアルカリ金属水酸化物を含むことができる。また、この水溶液にはその安定性を損なわないのであれば、他の有機溶媒、例えばアルコール類を添加しても差し支えない。

ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩あるいはその水溶液を出発物質とする場合も、前記ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のエポキシ化反応と同様な各種条件、各種反応触媒、各種有機溶剤および操作を用いてエポキシ化合物を得ることができる。また、粗エポキシ化合物を精製エポキシ化合物にする場合も、前述の方法が利用できる。

[0013]

通常、反応溶剤の留去はエポキシ化合物の融点近傍かそれ以上の温度で実施されるため、溶剤留去直後のエポキシ化合物は溶融状態である。この溶融状態のエポキシ化合物を結晶させ固形物とする方法としては特に指定がなく公知の方法を用いることができる。例えば、高温で溶融状態のエポキシ化合物をバット等に抜き出し自然冷却により結晶固形化する方法、抜き出した後、あらかじめ用意したそのエポキシ化合物の結晶固形物を結晶核として少量添加し結晶化を促進する方法、溶融状態のエポキシ化合物を撹拌したり、振動を与えるなどにより結晶化を促進する方法、二一ダーなどで強い外力を加えながら抜き出す方法、過冷却にならないように温度を管理しながら結晶化を促進させる方法などが上げられ、これらの方法を単独あるいは複数組み合わせて行うことができる。本発明の新規エポキシ化合物についても上記のような操作を行い、結晶化を促進することが、生産性の観点から望ましい。

また、エポキシ化合物の更なる低粘度化や高純度化のために、反応で得られた粗エポキシ化合物ないし精製エポキシ化合物を適当な溶剤を用いて再結晶してもよい。

[0014]

上記反応に用いるジヒドロアントラハイドロキノン化合物は一般式(II)において、置換基 $R^1 \sim R^{10}$ は水素原子または炭素数 1 から 6 までのアルキル基である。このうち、 $R^1 \sim R^{10}$ が水素原子またはメチル基が好ましく、特に好ましくは $R^1 \sim R^{10}$ すべて水素原子の場合である(1 、4 ージヒドロアントラハイドロキノン)。これより得られるエポキシ化合物は 8 0 ~ 1 2 0 ℃を示す結晶性であり、融点以上の温度において速やかに溶融するとともに極めて低い粘度となるので、取扱性に優れる。

また、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩を反応に用いる場合も上記と同様に、一般式(III)において置換基 $R^1 \sim R^{10}$ は水素原子または炭素数 1 から 6 までのアルキル基であり、このうち、 $R^1 \sim R^{10}$ が水素原子またはメチル基が好ましく、特に好ましくは $R^1 \sim R^{10}$ すべて水素原子の場合である(1, 4 ージヒドロアントラハイドロキノンのアルカリ金属塩)。

ここで塩を形成するアルカリ金属としては、カリウムないしナトリウムがあげられ、一般的には水酸化物(水酸化カリウムないし水酸化ナトリウム)として、そのままあるいは水ないしアルコールなどの溶剤に溶解させた形態で供給される。

[0015]

本発明の新規エポキシ化合物の原料である、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物の製造方法としては公知の方法が使用できる。例えば、1、4ーナフトキノンとブタジエンとのディールスアルダー反応により得られた1、4、4 a、9 a ーテトラヒドロアントラキノンを、溶媒としてペンゼンやキシレンなどの芳香族炭化水素、触媒としてパラトルエンスルホン酸を用い、80~100℃、30分~3時間かけて異性化反応させた後、冷却して結晶として得る方法(特開昭54-122263号公報)などがある。

同様に、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物の製造方法として

20

40

50

は公知の方法が使用できる。例えば、上記の方法により得られたジヒドロアントラハイドロキノン化合物を少なくとも当量(ジヒドロアントラハイドロキノン化合物の 2 倍モル)のアルカリ金属水酸化物が溶解した水溶液に溶解して得る方法や 1 、 4 ーナフトキノンとプタジエンとのディールスアルダー反応により得られた 1 、 4 、 4 a 、 9 a ーテトラヒドロアントラキノンを少なくとも当量(1 、 4 、 4 a 、 9 a ーテトラヒドロアントラキノンの 2 モル倍)のアルカリ金属水酸化物を溶解した水溶液と接触させることにより、 1 、 4 、 4 a 、 9 a ーテトラヒドロアントラキノンが異性化し、ジヒドロアントラハイドロキノン化合物のアルカリ金属塩物の水溶液として得ることができる。また、前述の一般式(11)において 11 において 11 において 11 にない 11 で、 11 で、 11 にない 11 で、 11 にない 11 で、 11 で、 11 にない 11 で、 1

[0016]

本発明の硬化性エポキン樹脂組成物は(a) 1 分子中にエポキシ基を 2 個以上有するエポキシ樹脂、(h)硬化剤、及び(c)硬化促進剤を必須成分としてなり、(a)のエポキシ樹脂中に、本発明の新規エポキシ化合物を含むことが特徴である。また(a)エポキシ樹脂中には、本発明の新規エポキシ化合物以外に 1 分子中にエポキシ基を 2 個以上有するエポキシ樹脂を併用することができ、そのエポキシ樹脂としては公知のエポキシ樹脂を用いることができる。例えば、ビスフェノール A型、ピスフェノール P型、ビフェニル型、テトラメチルピフェニル型、クレゾールノボラック型、フェノールノボラック型、ビフェニルでラック型、ジシクロペンタジエンフェノール縮合型、フェノールアラルキル縮合型などのエポキシ樹脂や脂環式エボキシ樹脂、脂肪族エポキシ樹脂が上げられる。これらエポキシ樹脂 1 種あるいは 2 種以上を混合して用いることができるが、本発明の工ポキシ樹脂全体中 5~100質量%である。配合量が 5 質量%より低いと本発明の効果が十分に発揮されない。

[0017]

(b) 硬化剤としては、特に指定はなく、公知のエポキシ樹脂硬化剤を用いることがで きる。それらのエポキシ樹脂硬化剤としては、例えば、ビスフェノールA、ビスフェノー ルF、ビスフェノールS、チオジフェノール、ハイドロキノン、レゾルシン、ビフェノー ル、テトラメチルビフェノール、ジヒドロキシナフタレン、ジヒドロキシジフェニルエー テルなどの多価フェノール類、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、 ビスフェノールAノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂、種々のフェノール類とベ ンズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、クロトンアルデヒド、グリオキザールな どの種々のアルデヒド類との縮合反応で得られるフェノール樹脂等、フェノールアラルキ ル樹脂、フェノール変性キシレン樹脂、フェノールテルペン樹脂、ジシクロペンタジエン フェノール樹脂などの各種フェノール樹脂類、各種フェノール(樹脂)類のフェノール性 水酸基の全部もしくは一部をベンゾエート化あるいはアセテート化などのエステル化によ り得られた活性エステル化合物、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フ タル酸、無水ピロメリット酸、メチルナジック酸などの酸無水物類、ジエチレントリアミ ン、イソホロジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、ジシ アンジアミド等のアミン類が上げられる、硬化剤は、1種単独でも、2種以上併用しても 良い。使用される硬化剤の使用量は、(a)エポキシ樹脂全成分中のエポキシ基1モルに 対して、全硬化剤中のエポキシ基と反応する基が0、5~2、0モルになる量が好ましく 、より好ましくは0.7~1、2モルである。

[0018]

(c) 硬化促進剤としては、特に指定はなく、公知の硬化促進剤を用いることができる。その硬化促進剤としては例えば、トリブチルホスフィン、トリフェニルホスフィン、トリス(ジメトキシフェニル)ホスフィン、トリス(ヒドロキシプロビル)ホスフィン、トリス(シアノエチル)ホスフィンなどのホスフィン化合物、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、メチルトリシアノエチルホスホニウムテトラフェニルボレートなどのホスホニウム塩、2ーメチルイ

ミダゾール、2一フェニルイミダゾール、2一エチルー4一メチルイミダゾール、2一ウ ンデシルイミダゾール、1ーシアノエチルー2ーメチルイミダゾール、2、4ージシアノ ー 6 ー [2 ーメチルイミダゾリルー(l)] ーエチルー s ートリアジン、2、4ージシア ノー 6 ー [2 ーウンデシルイミダゾリルー(1)]ーエチルー ς ートリアジンなどのイミダ ゾール類、1ーシアノエチルー2ーウンデシルイミダゾリウムトリメリテート、2-メチ ルイミダブリウムイソシアヌレート、2-エチルー4-メチルイミダブリウムテトラフェ エルボレート、2-エチルー1、4-ジメチルイミダブリウムテトラフェニルボレートな どのイミダゾリウム塩、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール、ベンジ ルジメチルアミン、テトラメチルブチルグアニジン、N-メチルピペラジン、2-ジメチ ルアミノー1ーピロリンなどのアミン類、トリエチルアンモニウムテトラフェニルボレー トなどのアンモニウム塩、11, 5ージアザビシクロ〔5, 4,0〕ーデーウンデセン、 1,5-ジアザビシクロ〔4,3,0〕-5-ノネン、1,4-ジアザビシクロ〔2,2 , 2] ーオクタンなどのジアザビシクロ化合物、それらジアザビシクロ化合物のテトラフ ェニルボレート、フェノール塩、フェノールノボラック塩、2-エチルヘキサン酸塩などが あげられる、それらの硬化促進剤となる化合物の中では、ホスフィン化合物、イミダゾー ル化合物、ジアザビシクロ化合物、及びそれらの塩が好ましい。それらの硬化促進剤は、 単独でまたは、2種以上混合して用いられ、その使用量は、全エポキシ化合物に対して。 0.1~7質量%である。

[0019]

また、本発明のエポキシ化合物の硬化性樹脂組成物には、必要に応じて充填材、カップリング剤、難燃剤、難燃助剤、可塑剤、溶剤、反応性希釈剤、顔料等を適宜に配合することができる。

本発明の硬化性エポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤など、全配合成分が均一に混合されていれば良く、従来より知られている方法と同様の方法を用いて組成物とすることができる。その方法としては例えば、ニーダー、ロールやエクストルーダーを用いた溶融混練や粉体状の成分を混合するドライブレンドがあげられる。このようにして得られた組成物は必要に応じて粉砕、分級などを行っても良い。

また、本発明の硬化性エポキシ樹脂組成物をアセトン、メチルエチルケトン、メチルセロソルブ、ジメチルホルムアミド、トルエン、キシレンなどの溶剤に溶解させ、ワニス状組成物とすることもできる。ガラス繊維、カーボン繊維、ボリエステル繊維、ポリアミド繊維、紙などの基材に含浸させ加熱乾燥してできたブリプレグを熱ブレス成形して硬化体を得ることができる。

本発明の硬化体は本発明の硬化性エポキシ樹脂組成物を熱硬化させることで得ることができ、成型物、積層物、注型物、接着剤、塗膜、フィルムなどの形態になる。例えば、形態が成型物の場合はその組成物を注型あるいはトランスファー成形機、射出成形機などを用い30~250℃で30秒~10時間加熱することにより硬化体を得ることができ、形態がワニス状の場合は、ガラス繊維、カーボン繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維、紙などの基材に含浸させ加熱乾燥してできたプリプレグを熱プレス成形して硬化体を得ることができる。

以上述べたように、本発明の新規エポキシ化合物は、常温で固体であり取り扱い性に優れ、かつ溶融状態において極めて低溶融粘度を有し、硬化性に優れており、この化合物を用いた硬化性エポキシ樹脂組成物は機械的強度、耐熱性及び耐湿性に優れた硬化体を与えることができるので、電気・電子部品の封止材料、成形材料、注型材料、積層材料、複合材料、接着剤及び粉体塗料等の用途に有用である。

【実施例】

[0020]

以下、実施例を上げて本発明を詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限りこれらの実施例に限定されるものではない。

(実施例1)

撹拌装置、環流冷却管および温度計を備えた容量3Lの4つロフラスコにエピクロルヒド

10

20

30

20

30

リン1050g、2ープロパノール410gを仕込み、系内を滅圧窒素置換した。これに、窒素雰囲気下、1、4ージヒドロアントラハイドロキノン200gを加え40℃に昇湿して均一に溶解させた後、48.5質量%の水酸化ナトリウム水溶液180gを90分かけて滴下した。その間に徐々に昇湿し、滴下終了後には系内が65℃になるようにした。その後、65℃で30分保持し反応を完了させ、水洗により副生塩および過剰の水酸化ナトリウムを除去した。ついで、生成物から減圧下で過剰のエピクロルヒドリンと2ープロパノールを留去して、粗製エポキシ樹脂混合物を得た。

[0021]

[(E 7]

図1は、実施例1で得られた化合物のH-NMRスペクトルを示す。 【0022】

【表 1 】

ケミカルシフト(ppm)	帰属される水素(式V)
2. 8~2. 9	На
3, 4~3, 50	Hb
3. 56	Hd
3.8~4.3	Hc .
6, 0	He
7. 4~7. 5	Hf
8. 0~8. 1	Hg

10

式V

[0023]

[18]

20

30

図2に、実施例1で得られた化合物のIRスペクトルを示す。

[0024]

(実施例2)

実施例1において1、4-ジヒドロアントラハイドロキノン200gのかわりに1、<math>4-ジヒドロ-2、3-ジメチルアントラハイドロキノン225gを用い、実施例1と同様の操作を行い、化学式(<math>V)で表されるエポキシ化合物 306gを得た。得られたエポキシ化合物のエポキシ当量194g/eq、加水分解性塩素 435ppm、150 における溶融粘度は17mpa・s、DSC 測定による融点は94 であった。GP とり化学式(VI)中、n=0 、1 であった。室温において黄色結晶性の固形であり取扱性は良好であった。

化学式 (VI)

[0025]

20

30

40

50

[化9]

[0026]

(実施例3)

撹拌装置、環流冷却管および温度計を備えた容量3Lの4つロフラスコにエピクロルヒドリン1050g、2ープロパノール410gを仕込み、系内を減圧窒素置換し、温度を40℃に維持した。これに、窒素雰囲気下、1、4ージヒドロアントラハイドロキノンナトリウム塩の28質量%水溶液900gを90分かけて滴下した。その間に徐々に昇温し、滴下終了後には系内が65℃になるよう温度制御した。その後、65℃で30分保持した後、液液分離により副性塩を含む水を排出した。次に、系内を65℃に保持したまま、48.5質量%水酸化ナトリウム水溶液32gを15分かけて滴下し、続いて30分かけて反応を完了させた。この後水洗により副性塩を除去し、さらに生成物から減圧下で過剰のエピクロルヒドリンと2-プロパノールを留去して、粗製エポキシ樹脂混合物を得た。

この粗製エポキシ樹脂混合物をメチルイソブチルケトン460gに溶解させ、48.5 質量%の水酸化ナトリウム水溶液7gを加え、65℃の温度で1時間反応させた。その後、反応液に第一リン酸水素ナトリウム水溶液を加えて、過剰の水酸化ナトリウムを中和し、水洗して副生塩を除去した。次いで、加温減圧下でメチルイソブチルケトンを完全に除去したのち、溶融状態の樹脂状物をバットに抜き出し、ガラス棒で十数回撹拌したのち、室温下にて自然冷却させた。約2時間後には全体が結晶固化しており、これをとりだし、黄色結晶状エポキシ化合物290gを得た。得られたエポキシ化合物のエボキシ当量174g/eg、加水分解性塩素390ppm、150℃における溶融粘度は15mPa・s、DSC測定による融点は106℃であり、室温において固形であり取扱性は良好であった。得られたエポキシ化合物のH-NMRおよびIRスペクトルは実施例1で得られたエポキシ化合物とほぼ同一であり、これらより化学式(IV)で表され、n=0.08(GPCより)であるエポキシ化合物が得

られたことを確認した。

[0027]

実施例 4~6

実施例 $1 \sim 3$ で得られたエポキシ化合物と、硬化剤としてフェノールノボラック樹脂(軟化点 8.4 \mathbb{C} 、水酸基当量 1.0.3 g / e q) およびフェノールアラルキル樹脂(軟化点 8.3 \mathbb{C} 、水酸基当量 1.7.5 g / e q) を用い所定量をガラスピーカー内で 1.2.0 \mathbb{C} にて溶融混合し、さらに硬化促進剤としてトリフェニルホスフィンを所定量添加してよく混合して得られた組成物を、注型し、 1.7.5 \mathbb{C} 、 7 時間アフターキュアさせ硬化物を得た。得られた硬化物の諸物性を表 2 に示した。

[0028]

(比較例1および2)

実施例4において実施例1で得られたエポキシ化合物の代わりに、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(常温で液状、150℃における粘度はI0mPa・s)、テトラメチルビフェノール型エポキシ樹脂(融点105℃、150℃における粘度は15mPa・s)をそれぞれ用い、実施例4と同様に硬化体を得、硬化物性を測定した結果を表2に示す。

以上より本発明のエポキシ化台物は結晶性樹脂であり、常温で固形であるので取り扱い性に優れ、溶融状態で極めて低粘度であった。またそのエポキシ化合物を用いた硬化性エポキシ樹脂組成物は硬化性、機械的強度、耐熱性および耐湿性に優れた硬化体を与えるという結果が得られた。

[0029]

[表2]

		実施例4	実施例5	楽施例 6	比較例1	比較例2
[配合] (phr)					**************************************
実施例1のエポキシ化合物		100.0	er for a fine a super a series a separature a person a februari	, this is the second		
実施例2のエポキシ化合物			100.0	***** ********************************		
実施例3のエポキシ化合物		n distributi dala di talah di periodi dalah yak di talah yak di talah di talah di talah di talah di talah di t		100.0	Debina a di Wisa di bahasan papanan ang arawa a	
ビスフェノールA型エポキシ樹脂		·	****		100.0	**********
テトラメチルピフェノール型コ	ボキシ機能			orani ya ya kamani amini a		100.0
フェノールノボラック樹脂	en ala mana dise a se al di ance de se al dispersa.	58.5	53.1	and a dimension of a superior of a superior of the superior of the superior of the superior of the superior of	55.4	
フェノールアラルキル樹脂	arteri errengen (a. 1976) a 1974 (a)		energia alimane atamba periodici di serie di seperativi di sipera	100.6		94.1
トリフェニルホスフィン	************	1.0	1, 0	1. 0	1. 0	1. 0
[物性]	THE PERSON NAMED OF THE PE			***************************************		
ゲルタイム(*1)	(粉)	6.0	63	7 2	7.0	95
ガラス転移温度(+2)	(%C)	167	162	145	115	120
曲げ強度(23℃)(*3)	(kg/mm²)	16.0	15.8	15.2	14.7	13.3
曲げ弾性率〈23℃〉(+3)	(kg/mm²)	370	361	324	315	274
曲if強度(250℃)(*3)	(kg/mm²)	0.34	0.31	0. 25	0.12	0. 11
曲げ弾性率 (250°C) (+3)	(kg/mn²)	3.4	3. 3	2. 9	2. 9	1. 8
吸湿率 (*4)	(%)	0, 71	0.69	0.64	0.90	0.72

(*1)熟板法. 1 7 5℃

(*2) T M A を用いて測定した、

(*3) JIS K6911 に従ってテストを行った。

(*4)85℃、85%RH 72hr後の吸湿率.

【産業上の利用可能性】

[0030]

本発明のエポキシ化合物は、結晶性を有し、常温で固体であるので取り扱い性に優れ、低溶融粘度を有し、これを用いた組成物は硬化性に優れ、機械強度と耐熱性、耐湿性に優れた硬化体を与えるので、封止材料、成形材料、接着剤、塗料等に有用である。

【図面の簡単な説明】

[0031]

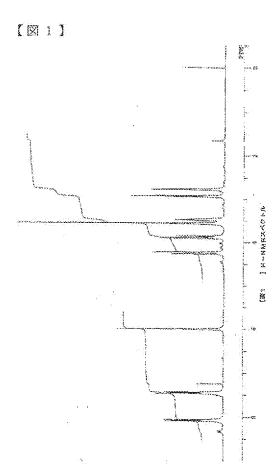
【図1】実施例1で得られたエポキシ化合物のH-NMRスペクトルを示すチャートである。

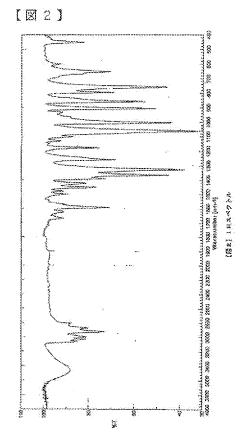
【図2】実施例1で得られたエポキシ化合物のIRスペクトルを示すチャートである。

10

20

30





フロントページの続き

【要約の続き】

(ただし、 $\mathbb{R}^1 \sim \mathbb{R}^{10}$ は水素原子または炭素数 1 から 6 までのアルキル基を示す。n は 0 以上の整数を示す。)と、その製造方法と、エポキシ樹脂組成物と硬化体に関する。

【選択図】 なし